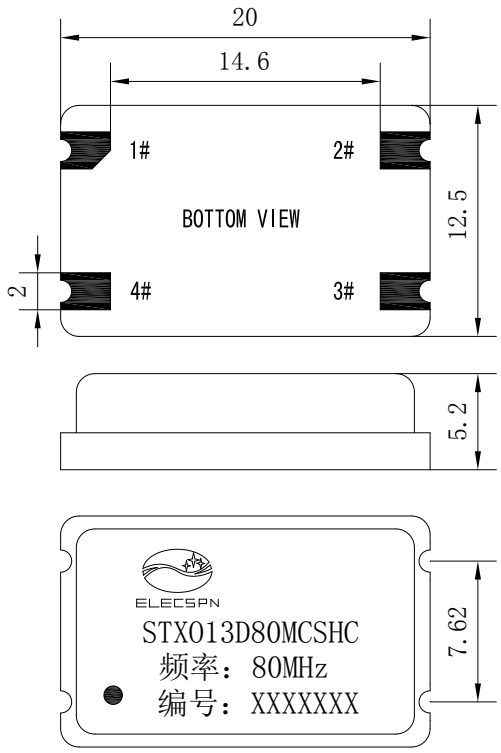
产品名称：温补晶体振荡器　　产品型号：STXO13D80MCSHC

技术指标项目			规格要求	
标称频率		✪ 80MHz	产品重量	□ 10g（Max）
外形尺寸		20×12.5×5.2mm³	密　　封	不适用
温度范围		工作温度	✪ -40℃～+85℃	
		储存温度	✪ -55℃～+85℃	
质量等级		军级(B)　执行规范：《STXO13 系列温补石英晶体振荡器详细规范》Q/TD 20288-2015		
电源电压	+5V±5%	工作电流	✪ ≤25mA	
输出		输出波形	✪ 正弦波	
		输出功率	✪ ≥7dBm（50Ω负载）	
		谐波	✪ ≤-30dBc	
		杂波响应	□ ≤-75dBc（带宽 10MHz～100MHz）	
			□ ≤-80dBc（带宽 10MHz）	
频率稳定性		基准温度下初始准确度	✪ ≤±1.0ppm（25℃±2℃ VCO=1.5V±0.1V）	
		频率温度稳定性	✪ ≤±1.0ppm（-40℃～+85℃）	
稳态相位噪声		✪ ≤-145dBc/Hz@1kHz		
老化		□ ≤±1.0ppm/年		
电频率调整		✪ ≥±3.0ppm（VCO=0～3V）		

外形图及引脚定义



引脚号	引脚功能
1#	压控/悬空（VCO/NC）
2#	接地（GND）
3#	输出（OUT）
4#	电源（VCC）

注：
1、晶振正面圆点对应 1#（压控）引脚。
2、晶振 1#（压控）引脚不使用时请悬空。
3、晶振编号由四位批次号及三位序列号组成，具体标识以实际产品为准。
4、尺寸未注公差：±0.3mm。

备注：
1、✪为必须满足的条件并作为产品检验的依据；□为设计保证的参考指标，不作为检验依据；
2、晶振采用 PCB 基板与金属外壳封装，为非密封结构，内部未采用键合工艺，可满足规定 DPA 试验要求（包括外部目检、X 射线检查、内部目检、剪切强度）；晶振内部晶体谐振器采用气密性陶瓷封装；
3、频率温度稳定性测试时温度增量为 10℃，其余指标为常温测试，高低温特性设计保证，使用方进货检验出现不合格，由承制方及时解决；
4、为避免内部焊点二次融化导致晶振受损，禁用再流焊焊接工艺，建议使用手工焊焊接，并控制焊接时间；
5、非密封结构，焊点清洗禁用浸泡清洗工艺，建议使用清洗剂擦洗工艺。

拟制：吴海钧　20180626　审核：刘建东　20180626　批准：苏松涛　20180626

中国·四川·成都市高新西区新业路 88 号天奥产业园　邮编：611731
电话：(86)28-87559314　传真：(86)28-87559313